

2-3 特殊平面研磨/研削用研磨機

2-3-1

硬組織標本 薄片自動研磨

スピードラップ (ML-521d)

〔概要〕

2枚のダイヤモンドラップ盤を、上面と下面に向かい合わせてあり、硬組織切片をあいだに挿入して研磨することにより、極薄の研磨薄片をつくる両面ラップ式の自動薄片研磨機です。

〔特長〕

- 1) 40mm角の骨切片を、標本には歪みなく10 μ m薄さに研磨できます。
- 2) 研磨作業は、薄切された組織片をセットするだけで、後は機械が自動的に研磨し、マイクロメータによる設定された厚さに達すると自動停止する自動定寸装置が付いています。
- 3) エアバランスによる加圧研磨方式で組織片の大きさや厚さにより、ラップ定盤の回転と加工圧（エア加圧）を調整することができます。

〈セット例〉

本 体	1) スピードラップ (ML-521d) 本体	1台
	2) ダイヤモンド上下ラップ盤 (ラップ盤 ϕ 150mm・#700)	1組
	3) 標準工具	1式



(ML-521d)

〔仕様〕

項 目	製品名	スピードラップ
主電動機	100V 120W	15~150min ⁻¹ (無段変速)
ダイヤモンドラップ盤	ϕ 150mm	
研磨可能な最大寸法	40×60mm	または 45×55mm
エアコンプレッサ	100V 200W	
使用空気圧	49×10 ⁻² Pa	
冷却水 (クーラント)	水道水源式 (直結)	
機体寸法	W550×L420×H1,190mm	
機体質量	100kg	

2-3-2

精密ラップ研削

ラポテスターGP2型 (MG-822GP2)

〔概要〕

本機はラップ研削、研磨（強制切り込み・定圧研磨）方式が1台できるので、新しい材料の研削・研磨加工及び加工条件テストなどが可能な装置です。

〔特長〕

- 1) ワンチャッキングで粗研削からラッピング・ポリシングの複合研削・研磨加工が可能です。（ラップ研削＝強制切込・定圧研磨）
- 2) ワークを下部にラップ工具を上部に取付、ラップ圧力を任意にコントロールできます。（9.8~784N）
- 3) ワークサイズ ϕ 200mmの鏡面加工が可能です。
- 4) ワーク部・ラップ部に真空チャックの取付も可能です。（オプション）

〔用途〕

シリコンウエハ、ハードディスク用基板（結晶化ガラス）、水晶振動子、メカニカルシール、ブロックゲージ、その他電子・光学部品の精密研削・研磨

〔仕様〕

項 目	製品名	ラポテスターGP2型
下ラップモータ	三相 200V	1.5kW
下ラップ回転数	0~500min ⁻¹	無段変速
下ラップ定盤直径	ϕ 200mm	
真空チャック	取付可能（オプション）	
加圧装置①定圧研磨	低摩擦シリンダーによる加圧 (加圧範囲：9.8~784N)	
加圧装置②強制切込	ステッピングモータによる切込み (最小切込設定値：0.01 μ m)	
ワークの大きさ	ϕ 100mm	
ワークモータ	三相 200V	1.5kW
ワーク回転数	0~2,000min ⁻¹ (無段変速)	
真空チャック	ワークが取付可能な構造（オプション）	
左右送りモータ	200V 25W	
左右送り速度	50mm/min (1/150)	
機体寸法	約W1,000×L1,100×H1,750mm	
機体質量	1,000kg	



(MG-822GP2)

〈セット例〉

本 体	1) ラポテスターGP2型 (MG-822GP2) 本体	1台
	2) フランジ	1個
	3) 標準工具	1式
オプション (選択)	4) 下部ラップ用真空チャック ϕ 200mm	1枚
	5) 上部ラップ用真空チャック ϕ 100mm	1枚
	6) クーラントタンク	1台
	7) ダイヤモンドカップホイール (ϕ 100, ϕ 125, ϕ 150mm)	各1個
	8) サーフェス定盤 鋳鉄 ϕ 200mm	1枚
	9) サーフェス定盤 MF銅 ϕ 200mm	1枚
	10) サーフェス定盤 MF錫 ϕ 200mm	1枚
	11) マジックプレート ϕ 200mm	1枚
	12) ポリシングクロス ϕ 200mm (硬質) 5枚入	1組
	13) ダイヤ液噴射装置 MKL-151-F	1式
	14) ELID電極ユニット	1式
	15) ELID電極装置	1式
	16) 鋳鉄バンド式ダイヤモンドカップホイール (ϕ 100, ϕ 125, ϕ 150mm)	各1個
	17) クーラント装置 (濾過装置付き)	1式

※ 研磨目的、試料の加工条件などにより、それぞれ適切な組合せが異なります。
詳細はお問い合わせ下さい。

※ ELID = 電解インプロセスドレッシング